

<AsiaNet>캘리포니아 마이크로 디바이시스, 스코트데일의 IMAPS 에서 WLCSP 페이퍼 발표

(스코트데일<미 애리조나주>3월 19일 AsiaNet=연합뉴스)캘리포니아 마이크로 디바이스는 애리조나주 스코트데일의 래디슨 포트 맥도웰 리조트 앤드 카지노에서 3월 17-20일에 열리는 국제 마이크로 패키징 학회(IMAPS) 제4회 연례 국제회 및 전시회에서 ASIP(Application Specific Integrated Passive(TM))제품의 기생적 요소를 최소화하도록 고안된 새로운 CSP 리배시베이션 기술에 관한 테크니컬 페이퍼를 공개할 것이라고 발표했다. 이 발표는 웨이퍼 레벨 칩 패키지 보드의 신뢰성에 관한 웨이퍼 레벨 칩 스케일(WLCSP)포럼이 후원하는 페이퍼들의 기술적 추적의 일환이다.

새로운 CSP 제조기술이 ASIP 성능과 신뢰성 개선

"ASIP 제품의 기생적 요소를 최소화하기 위한 새로운 리-패시베이션/RDL CSP 기술"이라는 제목의 이 페이퍼는 WLCSP 기술에서 기생적 요소의 역할을 다루고 CSP 기반의 정전기 방전(ESD)보호 제품과 전자파 방해(EMI)필터의 개선된 전기적 성능과 강화된 열역학적 신뢰성으로 통할 수 있는 최적화 리-패시베이션과 RDL 기술을 발표한다. 이 페이퍼는 캘리포니아 마이크로 디바이시스의 파운드리 엔지니어링과 운영 책임자인 우메시 샤르마 박사가 발표한다. 이 페이퍼는 컨퍼런스가 끝난 후 <http://www.cmd.com/applications/papers.php>의 기업 웹사이트나 <http://www.wlcspforum.org>의 웨이퍼 레벨 칩스케일 포럼 웹사이트에서 다운로드가 가능하다.

WLCSP 신뢰성에 관한 패널 토론

IMAPS 디바이스 패키징 컨퍼런스 기간에 WLCSP 포럼은 WLCSP 신뢰성에 관한 2회의 패널 토론회를 개최한다. 3월 18일에 열리는 첫 번째 세션에서는 캘리포니아 마이크로 디바이시스의 새로운 리-패시베이션 및 RDL CSP 기술과 WLCSP 포럼 회원들이 작성, 발표하는 4건의 다른 테크니컬 페이퍼가 발표된다. 이 패널 토론은 캘리포니아 마이크로 디바이시스의 카일 베이커 마케팅 담당 부사장 겸 WLCSP 포럼 회장이 공동 후원한다.

캘리포니아 마이크로 디바이시스 회사 소개

캘리포니아 마이크로 디바이시스(California Micro Devices Corporation)는 모바일 핸드셋, 디지털 가전제품 및 개인용 컴퓨터 시장에 어플리케이션 특정 아날로그 반도체와 혼합신호 반도체 제품을 공급하는 대표적 기업이다. 주요 제품은 모바일 핸드셋용 방호 장치, 디지털 TV 같은 디지털 가전제품, 개인용 컴퓨터, 그리고 모바일 핸드셋 디스플레이를 위한 아날로그와 혼합신호용 집적회로(IC)를 포함한다. 본사와 제품에 대한 자세한 정보는 웹사이트 www.cmd.com을 통해 조회할 수 있다.

ASIP와 Application Specific Integrated Passive는 캘리포니아 마이크로 디바이시스의 상표다. 기타 상표는 각 소유자의 자산이다.

자료제공: California Micro Devices

연락처: Richard Haas of California Micro Devices,
+1-408-934-3108,
richardh@cmd.com

웹사이트: <http://www.cmd.com>

(CAMD)

(㉞)